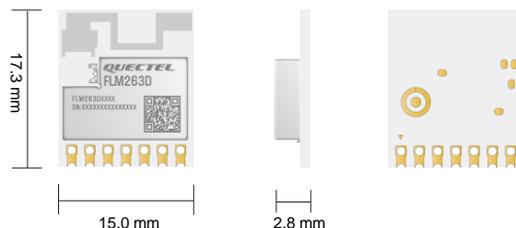


# Quectel FLM263D

## Wi-Fi 6 & BLE 5.2 模块 小尺寸 LCC + DIP 封装



FLM263D是移远通信推出的高性价比MCU Wi-Fi和蓝牙Combo模块，处理器主频高达320 MHz，支持IEEE 802.11b/g/n/ax协议和低功耗蓝牙（BLE 5.2），内置512 KB SRAM和4 MB Flash，符合WPA-PSK、WPA2-PSK及WPA3-SAE安全协议标准。

FLM263D为 LCC + DIP 封装，超紧凑的尺寸为17.3 mm × 15.0 mm × 2.8 mm，能最大限度地满足终端产品对小尺寸模块产品的需求，兼容多样化的结构设计。

FLM263D默认支持UART和GPIO，在QuecOpen®方案下可复用为PWM以及ADC等接口，多种低功耗模式和长连接保活机制，使其可灵活、广泛地应用于智能家居、工业物联网、消费电子等应用场景，满足不同的产品需求，尤其适用于智能照明等体积小、温度高的物联网设备，如球泡灯、灯带、智能插座等。

FLM263D支持QuecOpen®方案和标准AT指令集，具有精简的协议栈架构，可实现客户高效率产品开发。



### 产品特性

- ✓ Wi-Fi 6模块，单频2.4 GHz，1 × 1天线
- ✓ 支持BLE 5.2和蓝牙配网
- ✓ 内置PCB天线
- ✓ 超大内存，512 KB SRAM和4 MB Flash
- ✓ 超宽工作温度范围：-40 °C ~ +105 °C
- ✓ 高稳定性、高可靠性和全面的兼容性



IEEE 802.11b/g/n/ax



BLE 5.2



超大内存



尺寸紧凑



工作温度范围：  
-40 °C ~ +105 °C

## Wi-Fi 6 &amp; BLE 5.2

## FLM263D

WLAN 协议	IEEE 802.11b/g/n/ax
Wi-Fi 频段	2.4 GHz
Wi-Fi 调制方式	CCK/ BPSK/ QPSK/ 16QAM/ 64QAM
Wi-Fi 工作模式	AP/ STA/ STA + AP
蓝牙协议	BLE 5.2
加密模式	WPA-PSK/ WPA2-PSK/ WPA3-SAE
网络特性	IPv6
内核	RISC-V（主频高达320 MHz）
SRAM	512 KB
Flash	4 MB <sup>①</sup>
模块尺寸	17.3 mm × 15.0 mm × 2.8 mm
重量	约0.9 g

## 温度范围

工作温度 -40 °C ~ +105 °C

存储温度 -45 °C ~ +115 °C

## 认证

## 强制认证

中国：SRRC  
欧洲：CE  
美国：FCC  
加拿大：IC  
澳大利亚/新西兰：RCM

## 接口

天线接口 × 1（PCB天线）

外设接口<sup>②</sup> 默认支持UART和GPIO，复用情况下可支持PWM和ADC

## 电气特性

电源供电电压 3.0~3.6 V，典型值3.3 V

## 备注：

- ①：如有其他Flash规格需求，可联系移远通信销售。
- ②：接口详情可参考模块的硬件设计手册。

# Quectel FLM263D

Wi-Fi 6 & BLE 5.2

FLM263D

射频特性

	接收灵敏度	发射功率	
2.4 GHz	802.11b/1 Mbps	-98 dBm ±2 dB	18 dBm ±1 dB
	802.11b/11 Mbps	-89 dBm ±2 dB	18 dBm ±1 dB
	802.11g/6 Mbps	-91 dBm ±2 dB	15 dBm ±1 dB
	802.11g/54 Mbps	-74 dBm ±2 dB	14 dBm ±1 dB
	802.11n/HT20 MCS 0	-90 dBm ±2 dB	14 dBm ±1 dB
	802.11n/HT20 MCS 7	-72 dBm ±2 dB	13 dBm ±1 dB
	802.11ax/HE20 MCS 0	-90 dBm ±2 dB	14 dBm ±1 dB
	802.11ax/HE20 MCS 7	-72 dBm ±2 dB	13 dBm ±1 dB
BLE	1 Mbps	-94 dBm ±2 dB	11 dBm ±1 dB

采购编码

Flash

工作温度范围

天线

开发板（仅调试）

FLM263DAAMD-0P-04

4 MB

-40 °C ~ +105 °C

PCB天线

FLM263DAATB-0P-04